



Crème à braser hydrosoluble **WSP 2006**

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique WSP 2006

Ver: 3.11 31-08-15

Page 1

Crème à braser hydrosoluble sans halogènes

Description

WSP 2006 est une crème à braser hydrosoluble pour l'assemblage des composants CMS et la refusion.

Une crème hydrosoluble est sensible à un pourcentage d'humidité élevée et aux températures élevées. Il est recommandé de maintenir l'H.R. sous 60% et la température sous 30°C. Le temps entre la sérigraphie et la refusion devrait être le plus court possible.

La crème à braser **WSP 2006** possède de bonnes propriétés rhéologiques et une stabilité acceptable sur le pochoir ce qui lui donne une grande fenêtre de process en sérigraphie.

La crème a un bon mouillage sur la majorité des finitions

La crème à braser **WSP 2006** est absolument sans halogènes, sans résine et sans colophane.

Les résidus après refusion sont nettoyables à l'eau chaude (30-50°C) sans l'addition d'un produit saponifiant. Le nettoyage est obligatoire.

La crème est classée **OR MO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle



Plus d'informations :

<i>Profil de refusion</i>	P. 2
<i>Recommandations sur le profil</i>	P. 2
<i>Manipulation</i>	P. 3
<i>Résultats des tests</i>	P. 3
<i>Recommandations pour les paramètres</i>	P. 4

Avantages :

- Absolument sans halogènes
- Temps du pouvoir collant: >4 heures *
- Bon mouillage sur la majorité des finitions
- Résidus facilement nettoyables à l'eau chaude

* conditions de test sur simple demande

Disponibilité

alliages	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn96,5Ag3Cu0,5			
Sn95,5Ag3,8Cu0,7	sérigraphie: 86%	Standard: classe 3 (25— 45µ)	pot :250g/500g cartouche:
Sn95,5Ag4Cu0,5			
Sn99Ag0,3Cu0,7	Dosage:	Les classes 4 et 5 sont disponibles pour certains al- liages	6Oz: 500g/600g/700g
Sn98,5Ag0,8Cu0,7	83%		12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg seringue: 5CC/10CC/30CC
Sn95,8Ag4,2			
Sn99,3Cu0,7			
Autres alliages sur demande			autres conditionnements sur demande



Profil de refusion

Description Générale

Les profils de refusion linéaires ou avec un palier sont possibles. Des profils avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants ou bien pour di-

minuer ou éliminer la présence de « voids ». Avec la refusion par convection il faut atteindre le pic de refusion à 300s du début du profil. La bonne vitesse du convoyeur peut être calculée en divisant la longueur totale des zones de chauffage par la durée désirée du profil.

Quand vous brasez une carte avec un four à refusion, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une

bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion avec des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

Recommandations pour le profil

Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à environ 200°C une pente de 1-3°C/s est conseillée. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

Palier

A partir de 180°C jusqu'à environ 215°C avec une pente de 0-1°C/seconde. Dans certains cas un palier avec une température stable est utilisé pour rendre homogène les différences de températures sur la carte ou

afin de réduire la présence de "voids". Pour cela, généralement un palier de 20s à 90s. entre 200°C et 215°C est utilisé.

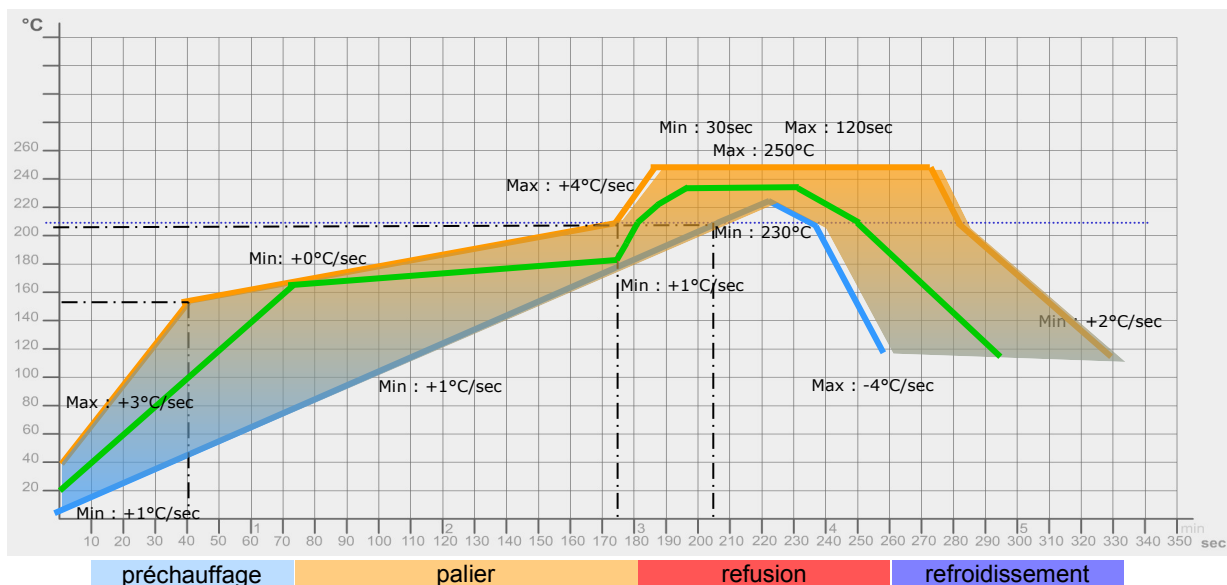
235°C et 250°C. Le temps au dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

Refroidissement

Environ - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.

Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifications des composants. En général entre





Manipulation

Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° à 7°C.

Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger la crème avant toute utilisation.

Sérigraphie

Une crème hydrosoluble est sensible à

l'humidité élevée et aux températures élevées. Si possible, il est recommandé de maintenir l' H.R. sous 60% et la température sous 30°C. Ne laissez pas la crème à braser sur le pochoir quand ce n'est pas nécessaire. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la crème à intervalle régulier.

Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie.

Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un

test de sérigraphie avant toute utilisation en production.

Nettoyage

Le nettoyage est obligatoire. Les résidus après refusion sont nettoyables à l'eau chaude (30°C-50°C) sans ou avec l'addition d'un produit saponifiant. Finaliser avec un rinçage avec de l'eau déminéralisée pure, c'est obligatoire.

Résultats des tests de fiabilité

conforme à la norme IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Argent chromate (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
«Spot test» (F)	passé	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35.1
Environnement		
	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
Mécanique		
Test d'effondrement	22°C 0,63mm	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,33mm	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
		passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	150°C 0,63mm	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,33mm	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,22mm	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
Test de mouillage		passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45



Recommandations et Paramètres d'utilisation

Sérigraphie

Vitesse : 20—70 mm/sec
Pression racles : ± 250 g /cm

Nettoyage : Toutes les 10 cartes
température d'utilisation : 15°C à 25°C

Pose des composants

Pouvoir collant « tack time » : > 4 heures

Refusion

Profil de refusion : Linéaire ou avec palier
Type de chauffe : Convection, phase vapeur,...

Test "in situ": appropriée pour: "flying probe"
Planche à clous

Nom commercial du produit : WSP 2006 Water Soluble Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com